



明新科技大學113學年度教師產業研習

半導體封裝製程與實務應用培訓營課程簡章

主辦單位	明新科技大學				
課程時間 / 課程名稱/師資	第一梯次(10天，共70小時)				
	日期	時間	培訓內容	講員	服務機構及職稱
	1/13 (一)	8:30 – 12:00	半導體構裝技術的演變	羅勉成	世芯電子公司專案顧問
		13:00 – 16:30	認識晶圓切割機組成與功能	何信松	力成科技公司資深工程師
	1/14 (二)	8:30 – 12:00	IC 先進製程的發展	呂明峯	明新科技大學 電子工程系教授
		13:00 – 16:30	晶圓切割機人機介面參數設定	何信松	力成科技公司資深工程師
	1/15 (三)	8:30 – 12:00	半導體封裝綜覽	蔡天寶	力成股份有限公司 封裝製造暨設備整合處處長
		13:00 – 16:30	晶圓切割機檢測與基本故障排除	何信松	力成科技公司資深工程師
	1/16 (四)	8:30 – 12:00	基礎半導體封裝概論	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
		13:00 – 16:30	晶圓切割機實務程序操作	何信松	力成科技公司資深工程師
	1/17 (五)	8:30 – 12:00	半導體封裝第一階層連接方式	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
		13:00 – 16:30	認識固晶機組成與功能	林賢昇	力成科技公司資深工程師
	1/20 (一)	8:30 – 12:00	典型封裝製程技術	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長



	13:00 – 16:30	固晶機人機介面參數設定	林賢昇	力成科技公司資深工程師
1/21 (二)	8:30 – 12:00	多晶片封裝模組製程技術	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
	13:00 – 16:30	固晶機檢測與基本故障排除	林賢昇	力成科技公司資深工程師
1/22 (三)	8:30 – 12:00	先進封裝概論	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
	13:00 – 16:30	固晶機實務程序操作	林賢昇	力成科技公司資深工程師
1/23 (四)	8:30 – 12:00	晶圓級封裝	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
	13:00 – 16:30	認識 QFN 封裝設備組成與功能	鄭國偉	廣化科技股份有限公司 業務處經理
1/24 (五)	8:30 – 12:00	面板級封裝	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
	13:00 – 16:30	QFN 封裝設備人機介面參數設定	陳慶恩	廣化科技股份有限公司 關鍵技術研發處 資深研發工程師



第二梯次(10 天，共 70 小時)

日期	時間	培訓內容	講員	服務機構
6/30 (一)	8:30 – 12:00	IC 先進製程整合先進封裝的需求	呂明峯	明新科技大學 電子工程系教授
	13:00 – 16:30	QFN 封裝設備檢測與基本故障排除	陳慶源	廣化科技股份有限公司 生產處資深工程師
7/1 (二)	8:30 – 12:00	先進封裝的發展趨勢	王欽宏	工研院電子與光電系統所 異質整合智能系統組組長
	13:00 – 16:30	QFN 封裝設備實務程序操作	陳慶源	廣化科技股份有限公司 生產處資深工程師
7/2 (三)	8:30 – 12:00	先進封裝的技術挑戰	張香鈺	工研院電子與光電系統所 異質整合智能系統組經理
	13:00 – 16:30	認識打線機組成與功能	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/3 (四)	8:30 – 12:00	先進封裝製程實務	張香鈺	工研院電子與光電系統所 異質整合智能系統組經理
	13:00 – 16:30	打線機人機介面參數設定	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/4 (五)	8:30 – 12:00	晶圓切割機實務問題導入演練	龐思全	矽格股份有限公司 封裝製程處長退休
	13:00 – 16:30	打線機檢測與基本故障排除	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/7 (一)	8:30 – 12:00	黏晶機實務問題導入演練	龐思全	矽格股份有限公司 封裝製程處長退休
	13:00 – 16:30	打線機實務程序操作	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/8 (二)	8:30 – 12:00	打線機實務問題導入演練	龐思全	矽格股份有限公司 封裝製程處長退休
	13:00 – 16:30	晶圓切割機操作能力檢測	何信松	力成科技公司資深工程師
7/9 (三)	8:30 – 12:00	IC 封裝產業環境汙染處理	江鏞帆	力成股份有限公司 工安二部副部經理
	13:00 – 16:30	固晶機操作能力檢測	林賢昇	力成科技公司資深工程師
7/10 (四)	8:30 – 12:00	封裝產業廠務系統介紹	盧麒泰	力成股份有限公司 廠務副部經理



		13:00 – 16:30	打線機操作能力檢測	黃志賢	力成科技公司資深工程師
	7/11 (五)	8:30 – 12:00	半導體封裝製程學習評量	趙守嚴	明新科技大學 電子工程系副教授兼 半導體學院副院長兼 半導體封測類產線營運長
		13:00 – 16:30	半導體封裝設備核心實務評量		
開課日期	第一梯次： 114年1月13日(一)至114年1月24日(五) 每周一至周五 早上8:30至16:30 第二梯次： 114年6月30日(一)至114年7月11日(五) 每周一至周五 早上8:30至16:30				
開課地點	明新科技大學逢喜樓(209教室)、半導體封裝測試類產線基地				
合作機構	明志科技大學教師產業研習研究專案辦公室 工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組 力成科技股份有限公司 廣化科技股份有限公司				
參與對象	高中職及大專院校教師				
收費標準	免費				
招生人數	招生人數40人				
報名網址	https://forms.gle/diykgwJHbWzRNGDi8				